

图书基本信息

书名：<<十一五电子发展基金成果汇编（上下）>>

13位ISBN编号：9787121138492

10位ISBN编号：7121138492

出版时间：2011-9

出版时间：中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部 电子工业出版社 (2011-09出版)

作者：周子学，李敬辉 编

页数：1334

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《“十一五”电子发展基金成果汇编（套装上下册）》是对“十一五”期间电子发展基金所支持项目成果的概括和总结。

全书分总体篇与产业篇，总体篇包括领导讲话、具有代表性的省（自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团）信息产业主管部门及有关中央直属企、事业单位“十一五”电子发展基金管理经验总结；产业篇主要介绍了各产业中有关项目承担单位“十五”电子发展基金使用管理经验与项目情况，包括软件和信息服务业、集成电路产业（含集成电路研发专项资金）、信息通信产业、数字视听产业、电子基础产业、信息技术应用、基地园区建设和重大发明产业化、创业投资八个方面。

章节摘录

插图：(1) 集成电路研发专项资金支持项目为“直径150-200mm重掺杂硅单晶技术研发”，支持金额300万元，其中用于人工费(含人才培养、引进)300万元，专用仪器及设备费104万元，咨询和培训费104万元，研发过程主材、辅料开发100万元。

该项目完成时累计经济效益指标：产品销售收入7776万元，净利润1374万元，交税总额486万元，创汇170万美元，社会贡献率36%，新增效益1448万元。

(2) 集成电路研发专项资金支持项目为“大规模集成电路用一种新型的增强型的吸杂硅抛光片研发和产业化”，支持金额500万元，主要用于人工费36万元，专用仪器和设备442万元(含外汇65万美元)，咨询和培训费17万元，差旅和会议费5万元。

项目自2010年9月试生产以来，到2010年年底这段建设期内累计实现销售收入116.01万元，目前根据计划进度逐步实现项目经济效益。

项目实施以来新增就业人数10人，同时新增台湾汉磊等客户3家。

(3) 集成电路研发专项资金支持项目为“12英寸硅单晶棒及8英寸集成电路级硅片技术研发和产业化”，支持金额300万元，主要用于购置设备120万元(含外汇15万美元)，工艺攻关试验原材料费100万元，工艺研发及聘请国内外技术专家费用180万元，其中用于项目研发专项奖励费用80万元。

项目自2008年12月小批量试生产以来，到2010年年底累计实现销售收入2465万元。

目前根据计划进度逐步实现项目经济效益。

编辑推荐

《"十一五"电子发展基金成果汇编(套装上下册)》由电子工业出版社出版。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>